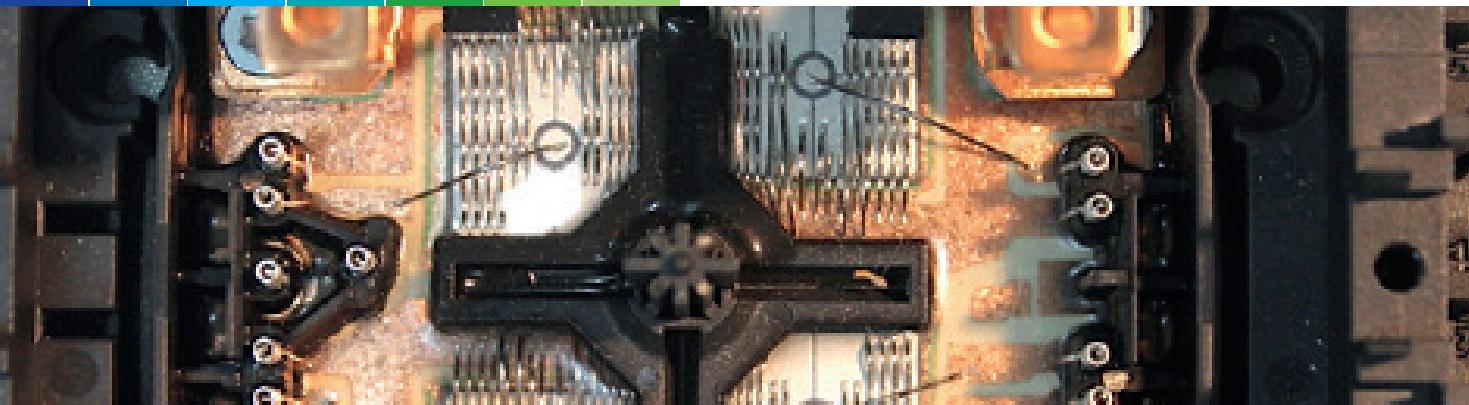


WEBINAR

Hochtemperatur Kontaktlöten für den Bereich Semiconductor/ Leistungselektronik



24. Juli 2024 um 9.00 Uhr

Bauteile mit hoher thermischer Masse, Profilanforderungen mit geringen Toleranzen, geringste Restsauerstoffwerte, flussmittelfreie Prozesse, Fügen unter Vakuum – all diese Anforderungen kommen auf Lötprozesse im Bereich der Leistungselektronik immer häufiger vor. Ebenso werden häufig Temperaturen von bis zu 400°C für das Fügen der Materialien benötigt.

Um in der Entwicklung von Leistungselektronik und im Bereich Semiconductor thermische Prozesse schnell flexibel, reproduzierbar und skalierbar abbilden zu können ist die Nexus als thermisches System optimal. Wärmeübertragung geschieht über Kontakt. Prozesse können mit geringsten Restsauerstoffwerten unter Stickstoff realisiert werden und gleichzeitig erlaubt das System den Einsatz von Ameisensäure und Formiergas zur Aktivierung und Reinigung der Oberflächen.

Im Webinar stellen wir die Anlage und ihre Anwendungsbereiche vor. Darüber hinaus werden wir thermische Profile mit speziellen Anforderungen diskutieren und in einem Show Case einen Prozess präsentieren. Seien Sie dabei wie im Webinar live aus komplexen Profilanforderungen ein Prozess entsteht.

Themenschwerpunkte des Webinars:

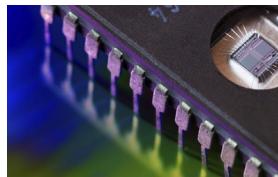
- Kontaktlöten
- Thermische Prozesse für Leistungselektronik
- Flexible Prozessentwicklung
- LIVE Prozess Demo

24. Juli 2024 um 9:00 Uhr

Registrierung: s.bartosch@rehm-group.com

Dauer des Webinars: 60 Min.

Vorbehaltlich inhaltlicher Anpassungen



TECHNOLOGY ACADEMY